



## 作者基本資料表

姓名	中文：
	英文：
服務單位	
現職	
最高學歷	
聯絡電話	
Email	
通訊地址	

敬請您於提供上開資料前，務必詳閱「財團法人資訊工業策進會蒐集個人資料告知事項暨個人資料提供同意書」(次頁)，如您同意提供，請於立同意書人欄位處簽名。

# 財團法人資訊工業策進會

## 蒐集個人資料告知事項暨個人資料提供同意書

版本：P-V5x-STLI

財團法人資訊工業策進會(下稱本會)受經濟部技術處補助並執行發行科技法律透析，為遵守個人資料保護法令及本會個人資料保護政策、規章，於向您蒐集個人資料前，依法向您告知下列事項，敬請詳閱。

### 一、蒐集目的及類別

本會因受經濟部技術補助並執行發行科技法律透析、提供服務及供本會用於內部行政管理、陳報主管機關或其他合於本會捐助章程所定業務、寄送本會或產業相關活動訊息之蒐集目的，而需獲取您下列個人資料類別：姓名(中文)、姓名(英文)、服務單位、現職、最高學歷、聯絡電話、Email、通訊地址。

※您日後如不願再收到本會所寄送之行銷訊息，可於收到前述訊息時，直接點選訊息內拒絕接受之連結。

### 二、個人資料利用之期間、地區、對象及方式

除涉及國際業務或活動外，您的個人資料僅供本會於中華民國領域、在前述蒐集目的之必要範圍內，以合理方式利用至蒐集目的消失為止。

### 三、當事人權利

您可依前述業務、活動所定規則或依本會網站 (<https://www.iii.org.tw/>)「個資當事人行使權利專頁」公告方式向本會行使下列權利：

- (一) 查詢或請求閱覽。
- (二) 請求製給複製本。
- (三) 請求補充或更正。
- (四) 請求停止蒐集、處理及利用
- (五) 請求刪除您的個人資料。

### 四、不提供個人資料之權益影響

若您未提供正確或不提供個人資料，本會將無法為您提供蒐集目的之相關服務。

### 五、您瞭解此一同意書符合個人資料保護法及相關法規之要求，且同意本會留存此同意書，供日後取出查驗。

## 個人資料之同意提供：

- 一、本人已充分獲知且已瞭解上述貴會告知事項。
- 二、本人同意貴會於所列蒐集目的之必要範圍內，蒐集、處理及利用本人之個人資料。

**立同意書人：**

中 華 民 國 年 月 日